



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110808000
2011 年 8 月 16 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HVAL C10 プロセス 一部製品 前処理サイト追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐	-
変更内容	HVAL C10プロセス 一部製品 前処理サイト追加 現行 : TI-FFAB(Freising, ドイツ) 変更後 : TI-FFAB(Freising, ドイツ), TI-CFAB(中国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	11 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	-			

変更内容

内容:弊社 HVAL(ハイボリュームアナログロジック) C10プロセス 一部製品の前処理サイトについて、現行 TI-FFAB(Freising, ドイツ)サイトにて製造いたしておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-CFAB(中国)サイトでの製造を追加します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

前処理サイト

現行

TI-FFAB(Freising, ドイツ)

変更後

TI-FFAB(Freising, ドイツ)

TI-CFAB(中国)

ウェーハ径

200 mm

200 mm

理由 : 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
74ALVCH16973DGGRE4	SN74AVC4T245DGVR	SN74LVC1G04DCKTE4	SN74LVC1G17DBVTE4	SN74LVC1G97DBVTE4
74ALVCH16973DGGRG4	SN74AVC4T245DGV	SN74LVC1G04DCKTG4	SN74LVC1G17DBVTG4	SN74LVC1G97DBVTG4
74ALVCH16973DGVRE4	SN74AVC4T245DR	SN74LVC1G04DRLR	SN74LVC1G17DCK3	SN74LVC1G97DCK3
74ALVCH16973DGVRG4	SN74AVC4T245DRE4	SN74LVC1G04DRLRG4	SN74LVC1G17DCK6	SN74LVC1G97DCK6
74ALVCH16973DLG4	SN74AVC4T245DRG4	SN74LVC1G04DSFR	SN74LVC1G17DCKR	SN74LVC1G97DCKR
74ALVCH32973ZKER	SN74AVC4T245DT	SN74LVC1G06DBVR	SN74LVC1G17DCKRE4	SN74LVC1G97DCKRE4
74AVC16T245DGGRE4	SN74AVC4T245DTE4	SN74LVC1G06DBVRE4	SN74LVC1G17DCKRG4	SN74LVC1G97DCKRG4
74AVC16T245DGGRG4	SN74AVC4T245DTG4	SN74LVC1G06DBVRG4	SN74LVC1G17DCKT	SN74LVC1G97DCKT
74AVC16T245DGGRG4	SN74AVC4T245PW	SN74LVC1G06DBVT	SN74LVC1G17DCKTE4	SN74LVC1G97DCKTE4
74AVC16T245DGVRE4	SN74AVC4T245PWE4	SN74LVC1G06DBVTE4	SN74LVC1G17DCKTG4	SN74LVC1G97DCKTG4
74AVC16T245DGVRG4	SN74AVC4T245PWG4	SN74LVC1G06DBVTG4	SN74LVC1G17DRLR	SN74LVC1G97DRLR
74AVC4T245DGVRE4	SN74AVC4T245PWR	SN74LVC1G06DCK3	SN74LVC1G17DRLRG4	SN74LVC1G97DRLRG4
74AVC4T245DGVRG4	SN74AVC4T245PWRE4	SN74LVC1G06DCK6	SN74LVC1G17DSFR	SN74LVC1G98DBVR
74AVC4T245RGYRG4	SN74AVC4T245PWG4	SN74LVC1G06DCKR	SN74LVC1G3157DBVR	SN74LVC1G98DBVRE4
74AVC4T245RSVRG4	SN74AVC4T245PWT	SN74LVC1G06DCKRE4	SN74LVC1G3157DCK3	SN74LVC1G98DBVRG4
74AVC8T245DGVRE4	SN74AVC4T245PWTE4	SN74LVC1G06DCKRG4	SN74LVC1G3157DCKR	SN74LVC1G98DBVT
74AVC8T245DGVRG4	SN74AVC4T245PWG4	SN74LVC1G06DCKT	SN74LVC1G3157DRLR	SN74LVC1G98DBVTE4
74AVC8T245RHLRG4	SN74AVC4T245RGYR	SN74LVC1G06DCKTE4	SN74LVC1G3157DRYR	SN74LVC1G98DBVTG4
74AVCH4T245DGVRE4	SN74AVC4T245RSVR	SN74LVC1G06DCKTG4	SN74LVC1G32DBV3	SN74LVC1G98DCK6
74AVCH4T245DGVRG4	SN74AVC8T245DGVR	SN74LVC1G06DRLR	SN74LVC1G32DBVR	SN74LVC1G98DCKR

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

74AVCH4T245PWRE4	SN74AVC8T245PW	SN74LVC1G06DRLRG4	SN74LVC1G32DBVRE4	SN74LVC1G98DCKRE4
74AVCH4T245PWG4	SN74AVC8T245PWE4	SN74LVC1G06DRYR	SN74LVC1G32DBVRG4	SN74LVC1G98DCKRG4
74AVCH4T245PWTE4	SN74AVC8T245PWG4	SN74LVC1G06DSFR	SN74LVC1G32DBVT	SN74LVC1G98DCKT
74AVCH4T245PWTG4	SN74AVC8T245PWR	SN74LVC1G07DBVR	SN74LVC1G32DBVTE4	SN74LVC1G98DCKTE4
74AVCH4T245RGYRG4	SN74AVC8T245PWRE4	SN74LVC1G07DBVRE4	SN74LVC1G32DBVTG4	SN74LVC1G98DCKTG4
74AVCH4T245RSVRG4	SN74AVC8T245PWG4	SN74LVC1G07DBVRG4	SN74LVC1G32DCK3	SN74LVC1G98DRLR
74LVC1G3157DBVRE4	SN74AVC8T245RHLR	SN74LVC1G07DBVT	SN74LVC1G32DCK6	SN74LVC1G98DRLRG4
74LVC1G3157DBVRG4	SN74AVCH4T245D	SN74LVC1G07DBVTE4	SN74LVC1G32DCKR	SN74LVC1GU04DBVR
74LVC1G3157DCKRE4	SN74AVCH4T245DE4	SN74LVC1G07DBVTG4	SN74LVC1G32DCKRE4	SN74LVC1GU04DBVT
74LVC1G3157DCKRG4	SN74AVCH4T245DG4	SN74LVC1G07DCK3	SN74LVC1G32DCKRG4	SN74LVC1GU04DCK3
74LVC1G3157DRLRG4	SN74AVCH4T245DGV	SN74LVC1G07DCK6	SN74LVC1G32DCKT	SN74LVC1GU04DCK6
74LVC1G3157DRYRG4	SN74AVCH4T245DGV	SN74LVC1G07DCKR	SN74LVC1G32DCKTE4	SN74LVC1GU04DCKR
74LVC1GU04DBVRE4	SN74AVCH4T245DR	SN74LVC1G07DCKRE4	SN74LVC1G32DCKTG4	SN74LVC1GU04DCKT
74LVC1GU04DBVRG4	SN74AVCH4T245DRE4	SN74LVC1G07DCKRG4	SN74LVC1G32DRLR	SN74LVC1GU04DRLR
74LVC1GU04DBVTE4	SN74AVCH4T245DRG4	SN74LVC1G07DCKT	SN74LVC1G32DRLRG4	SN74LVC1GU04DRYR
74LVC1GU04DBVTG4	SN74AVCH4T245DT	SN74LVC1G07DCKTE4	SN74LVC1G32DSFR	SN74LVC1GU04DSFR
74LVC1GU04DCKRE4	SN74AVCH4T245DTE4	SN74LVC1G07DCKTG4	SN74LVC1G34DBVR	TPD2E001DRLR
74LVC1GU04DCKRG4	SN74AVCH4T245DTG4	SN74LVC1G07DRLR	SN74LVC1G34DBVRE4	TPD2E001DRLRG4
74LVC1GU04DCKTE4	SN74AVCH4T245PW	SN74LVC1G07DRLRG4	SN74LVC1G34DBVRG4	TPD2E001DRSR
74LVC1GU04DCKTG4	SN74AVCH4T245PWE4	SN74LVC1G07DRYR	SN74LVC1G34DBVT	TPD2E001DRYR
74LVC1GU04DRLRG4	SN74AVCH4T245PWG4	SN74LVC1G07DRYRG4	SN74LVC1G34DBVTE4	TPD2E001DRYRG4
AVC16T245DGGR-D	SN74AVCH4T245PWR	SN74LVC1G07DSFR	SN74LVC1G34DBVTG4	TPD2E001DZDR
AVC16T245DGV-R	SN74AVCH4T245PWT	SN74LVC1G08DBV3	SN74LVC1G34DCKR	TPD3E001DRLR
AVC16T245ZQLR-D	SN74AVCH4T245RGYR	SN74LVC1G08DBV6	SN74LVC1G34DCKRE4	TPD3E001DRLRG4
AVC32T245ZKER-D	SN74LVC1G00DBV3	SN74LVC1G08DBVR	SN74LVC1G34DCKRG4	TPD3E001DRSR
AVC8T245DGV-R	SN74LVC1G00DBVR	SN74LVC1G08DBVRE4	SN74LVC1G34DCKT	TPD3E001DRYR
AVC8T245PWR-D	SN74LVC1G00DBVRE4	SN74LVC1G08DBVRG4	SN74LVC1G34DCKTE4	TPD3E001DRYRG4
AVC8T245RHLR-D	SN74LVC1G00DBVRG4	SN74LVC1G08DBVT	SN74LVC1G34DCKTG4	TPD4E001DBVR
HPA00671DGGR	SN74LVC1G00DBVT	SN74LVC1G08DBVTE4	SN74LVC1G34DRLR	TPD4E001DRLR
HPA00719RSVR	SN74LVC1G00DBVTE4	SN74LVC1G08DBVTG4	SN74LVC1G34DRLRG4	TPD4E001DRLRG4
HPA00720RHLR	SN74LVC1G00DBVTG4	SN74LVC1G08DCK3	SN74LVC1G34DRYR	TPD4E001DRSR
HPA00782DRLR	SN74LVC1G00DCK3	SN74LVC1G08DCK6	SN74LVC1G34DSFR	TPD6E001RSER
HPA00961RHUR	SN74LVC1G00DCK6	SN74LVC1G08DCKR	SN74LVC1G38DBVR	TPD6E001RSE4
HPA01002DCKR	SN74LVC1G00DCKR	SN74LVC1G08DCKRE4	SN74LVC1G38DBVRE4	TPD6E001RSFR
HPA01003DCKR	SN74LVC1G00DCKRE4	SN74LVC1G08DCKRG4	SN74LVC1G38DBVRG4	TPD6E001RSFRG4
MP1TS5A23159-D	SN74LVC1G00DCKRG4	SN74LVC1G08DCKR-LI	SN74LVC1G38DBVT	TS3L500AERHUR
MP1TS5A23159-W	SN74LVC1G00DCKT	SN74LVC1G08DCKT	SN74LVC1G38DBVTE4	TS3L500AERHURG4
MP1TXB0104-W	SN74LVC1G00DCKTE4	SN74LVC1G08DCKTE4	SN74LVC1G38DBVTG4	TS3USB221DRCR
SN0401022DCKRG4	SN74LVC1G00DCKTG4	SN74LVC1G08DCKTG4	SN74LVC1G38DCKR	TS3USB221DRCRG4
SN0401023DCKRG4	SN74LVC1G00DRLR	SN74LVC1G08DRLR	SN74LVC1G38DCKRE4	TS3USB221RSER
SN0710020RGYR	SN74LVC1G00DRLRG4	SN74LVC1G08DRLRG4	SN74LVC1G38DCKRG4	TS3USB221RSE4
SN080104RSER	SN74LVC1G00DRYR	SN74LVC1G08DRYR	SN74LVC1G38DCKT	TS5A23159DGS
SN74ALVCH16973DGGR	SN74LVC1G00DSFR	SN74LVC1G08DRYRG4	SN74LVC1G38DCKTE4	TS5A23159DGSRE4
SN74ALVCH16973DGV	SN74LVC1G02DBV6	SN74LVC1G08DSFR	SN74LVC1G38DCKTG4	TS5A23159DGSRG4
SN74ALVCH16973DL	SN74LVC1G02DBVR	SN74LVC1G11DBVR	SN74LVC1G38DRYR	TS5A23159DGST
SN74ALVCH32973KR	SN74LVC1G02DBVRE4	SN74LVC1G11DBVRE4	SN74LVC1G38DSFR	TS5A23159DGST4
SN74AUP1G08DRYR	SN74LVC1G02DBVRG4	SN74LVC1G11DBVRG4	SN74LVC1G57DBVR	TS5A23159DGSTG4
SN74AUP1G08DSFR	SN74LVC1G02DBVT	SN74LVC1G11DCKR	SN74LVC1G57DBVRE4	TS5A23159RSER
SN74AUP1G32YZPR	SN74LVC1G02DBVTE4	SN74LVC1G11DCKRE4	SN74LVC1G57DBVRG4	TS5A23159RSE4
SN74AUP1G58YZTR	SN74LVC1G02DBVTG4	SN74LVC1G11DCKRG4	SN74LVC1G57DCKR	TS5A3157DBVR
SN74AVC16T245DGG	SN74LVC1G02DCK3	SN74LVC1G14DBV3	SN74LVC1G57DCKRE4	TS5A3157DBVRE4
SN74AVC16T245DGGR	SN74LVC1G02DCK6	SN74LVC1G14DBV6	SN74LVC1G57DCKRG4	TS5A3157DBVRG4
SN74AVC16T245DGV	SN74LVC1G02DCKR	SN74LVC1G14DBVR	SN74LVC1G57DRLR	TS5A3157DCKR
SN74AVC16T245GQLR	SN74LVC1G02DCKRE4	SN74LVC1G14DBVRE4	SN74LVC1G57DRLRG4	TS5A3157DCKRE4
SN74AVC16T245ZQLR	SN74LVC1G02DCKRG4	SN74LVC1G14DBVRG4	SN74LVC1G66DBVR	TS5A3157DCKRG4
SN74AVC1T45DBVR	SN74LVC1G02DCKT	SN74LVC1G14DBVT	SN74LVC1G66DBVRE4	TS5A3159AYZPR

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

SN74AVC1T45DBVRE4	SN74LVC1G02DCKTE4	SN74LVC1G14DBVTE4	SN74LVC1G66DBVRG4	TS5A6542YZTR
SN74AVC1T45DBVRG4	SN74LVC1G02DCKTG4	SN74LVC1G14DBVTG4	SN74LVC1G66DBVT	TXB0104D
SN74AVC1T45DBVT	SN74LVC1G02DRLR	SN74LVC1G14DCK3	SN74LVC1G66DBVTE4	TXB0104DG4
SN74AVC1T45DBVTE4	SN74LVC1G02DRLRG4	SN74LVC1G14DCK6	SN74LVC1G66DBVTG4	TXB0104DR
SN74AVC1T45DBVTG4	SN74LVC1G02DRYR	SN74LVC1G14DCKR	SN74LVC1G66DCK3	TXB0104DRG4
SN74AVC1T45DCKR	SN74LVC1G02DSFR	SN74LVC1G14DCKRE4	SN74LVC1G66DCK6	TXB0104GXUR
SN74AVC1T45DCKRE4	SN74LVC1G04DBVR	SN74LVC1G14DCKRG4	SN74LVC1G66DCKR	TXB0104PWR
SN74AVC1T45DCKRG4	SN74LVC1G04DBVRE4	SN74LVC1G14DCKT	SN74LVC1G66DCKRE4	TXB0104PWRG4
SN74AVC1T45DCKT	SN74LVC1G04DBVRG4	SN74LVC1G14DCKTE4	SN74LVC1G66DCKRG4	TXB0104RGYR
SN74AVC1T45DCKTE4	SN74LVC1G04DBVT	SN74LVC1G14DCKTG4	SN74LVC1G66DCKT	TXB0104RGYRG4
SN74AVC1T45DCKTG4	SN74LVC1G04DBVTE4	SN74LVC1G14DRLR	SN74LVC1G66DCKTE4	TXB0104ZXUR
SN74AVC1T45DRLR	SN74LVC1G04DBVTG4	SN74LVC1G14DRLRG4	SN74LVC1G66DCKTG4	TXS0102DQER
SN74AVC1T45DRLRG4	SN74LVC1G04DCK3	SN74LVC1G14DSFR	SN74LVC1G66DRLR	TXS0102DQMR
SN74AVC32T245GKER	SN74LVC1G04DCK6	SN74LVC1G17DBV3	SN74LVC1G66DRLRG4	TXS0102YZPR-LI
SN74AVC32T245ZKER	SN74LVC1G04DCKR	SN74LVC1G17DBVR	SN74LVC1G97DBVR	TXS0104EYZTR
SN74AVC4T245D	SN74LVC1G04DCKRE4	SN74LVC1G17DBVRE4	SN74LVC1G97DBVRE4	
SN74AVC4T245DE4	SN74LVC1G04DCKRG4	SN74LVC1G17DBVRG4	SN74LVC1G97DBVRG4	
SN74AVC4T245DG4	SN74LVC1G04DCKT	SN74LVC1G17DBVT	SN74LVC1G97DBVT	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)及び生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記のようになります。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	T1-FFAB	T1-CFAB
CS0 (20L): 前処理サイト記号	TID	CU3
CC0 (21L): 生産国記号	DEU	CHN



図1 出荷ラベルの例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2011 年 7 月	終了	2011 年 10 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74AVC16T245DGGR	-	-	
Wafer Fab Site:	CFAB	Wafer Fab Process:	33C10	
Wafer Diameter(mm):	200	Passivation:	10KACN	
Metallization:	Ti/TiN/AICu 0.5%/TiN	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	77	77	77
High Temp. Storage Bake	170C, 168, 420 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD HBM	2000V	3	3	3
ESD CDM	500V	3	3	3
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Wafer level Reliability	Approved by TDQRE	per spec	per spec	per spec
Wafer Fab MQ	Per site spec	per spec	per spec	per spec
Assembly / Test MQ	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Latch-up	per JESD78	6	6	6
X-ray	top side only	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	-	-
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2011 年 7 月	終了	2011 年 10 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TXS0102DQE	-	-	
Wafer Fab Site:	CFAB	Wafer Fab Process:	33C10	
Wafer Diameter(mm):	200	Passivation:	10KACN	
Metallization:	Ti/TiN/NCu0.5%/TiN	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	-	-
Electrical Characterization	-	per spec	-	-
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD HBM	2000V	3	-	-
ESD CDM	500V	3	-	-
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Die Shear	-	10	10	10
Latch-up	per JESD78	6	-	-
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Wafer Fab MQ	per mfg. Site specification	per spec	-	-
X-ray	top side only	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	-	-
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-1/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2011 年 7 月	終了	2011 年 10 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TS3L500AERHUR	-	-	
Wafer Fab Site:	CFAB	Wafer Fab Process:	33C10	
Wafer Diameter(mm):	200	Passivation:	10KACN	
Metallization:	Ti/TiN/NCu 0.5%/TiN	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
High Temp. Storage Bake	170C, 168, 420 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD HBM	2000V	3	3	3
ESD CDM	500V	3	3	3
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Wafer level Reliability	Approved by TDQRE	per spec	per spec	per spec
Latch-up	per JEDEC78	6	6	6
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Wafer Fab MQ	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	top side only	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	-	-
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2011 年 7 月	終了	2011 年 10 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74AVC2T245RSWR	-	-	
Wafer Fab Site:	CFAB	Wafer Fab Process:	33C10	
Wafer Diameter(mm):	200	Passivation:	10KACN	
Metallization:	TiW/AlCu 0.5%	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	-	-
Electrical Characterization	-	per spec	-	-
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD HBM	2000V	3	-	-
ESD CDM	500V	3	-	-
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Die Shear	-	10	10	10
Latch-up	per JEDEC78	6	-	-
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Wafer Fab MQ	per mfg. Site specification	per spec	-	-
X-ray	top side only	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	-	-
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-1/260C				